

EM3155R-L

免洗助焊剂

产品描述

EM3155R-L 含卤化物，配方中的松香成份已最小化，可用于现代电子装配焊接。对高密度贴片芯片和通孔元件表现优良。之后的残留物是不粘的。

操作

EM3155R-L 设计成可使用发泡，喷雾，浸渍和刷涂等工艺来操作。推荐上层预热温度 100-120 °C。

物理性质和可靠性数据

物理性质和可靠性数据	规格	测试方法	结果 (典型的)
助焊剂类型	-	-	免洗
等级类型	查阅 J-STD-004	-	ROL1
颜色和外观	-	-	透明淡黄色液体
气味	-	-	醇样气味
闪点 (开口)	-	-	18 °C
比重(@25°C	-	-	0.802 ± 0.005
含固量	-	J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.3.34	6.0 ± 2.0 %
卤化物含量 (%) (氯化物和溴化物)	Max 0.1%	JIS Z 3197, Method 8.1.4.2.1	0.06 ± 0.02%
酸值	-	J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.3.13	18.0 – 24.0 mg KOH/g
腐蚀测试	-	J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.6.15	合格
表面绝缘阻抗(典型的) 85°C / 85% RH 168 小时	Min 1 x 10 ⁸ Ω	J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.6.3.3	≥ 1 X 10 ¹⁰ Ω

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用。

湿润特性

EM3155R-L 湿润平衡测试

使用仪器: GEN 3 System - MUST System II Solderability Tester

测试参数	
测试铜板尺寸	25mm x 6mm x 0.5mm
检测温度	260 °C
沉浸深度	5 mm
沉浸速度	20 mm/s
测试/ 沉浸时间	5s

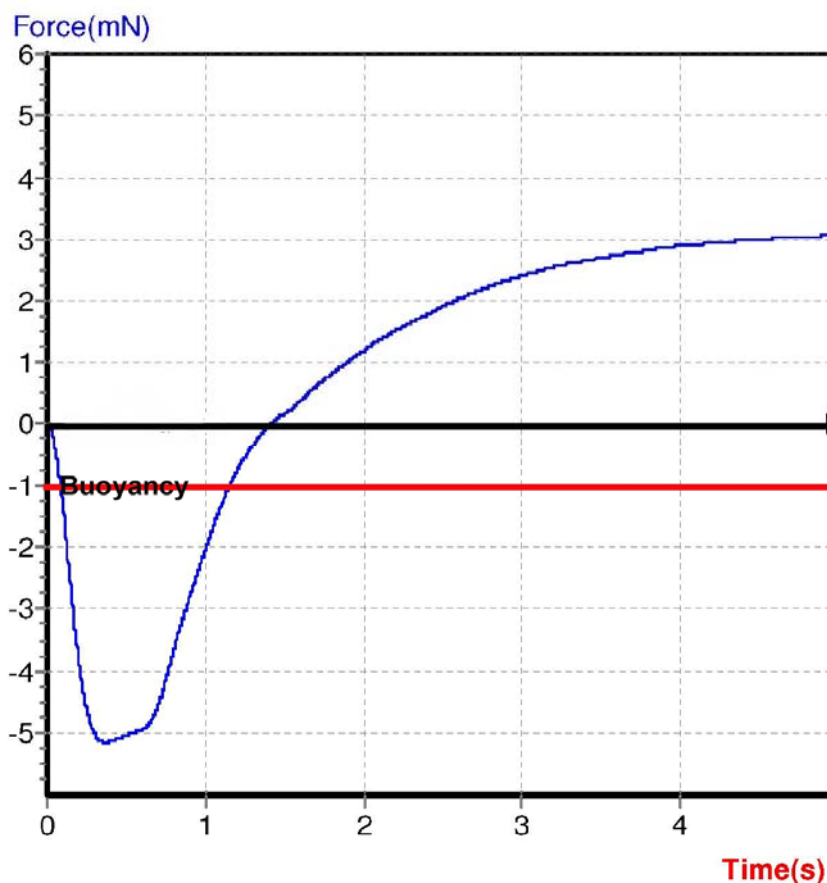


Figure 1: 用于 LF-307B 无铅合金时 EM3155R-L 的湿润特性

结果: 最大湿润力, F_{max} (mN): 3.065
符合 J-STD-003B 湿润平衡参数和建议标准。

在此宣传册里的信息和声明均是可信的, 但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的适用性, 用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的, 不可以作为规格使用。

稀释

EM3155R-L 在正常工作状态下会有少许蒸发，为了保持其原始浓度，应采用稀释方法。

包装

25 litres 一桶或 200 litres 一桶。

贮存

EM3155R-L 助焊剂是含有醇类成分的易燃品，须避火保存。

健康和安全

在安全和健康问题上，请参考材料安全数据表。

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用。